

2020-2026年中国LED外 延片产业发展现状与发展前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国LED外延片产业发展现状与发展前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/174519.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

LED外延片是一块加热至适当温度的衬底基片，材料是半导体照明产业发展的基石。不同的衬底材料，需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。中企顾问网发布的《2020-2026年中国LED外延片产业发展现状与发展前景报告》分析了LED外延片行业的产业链，竞争格局，面临的机遇及挑战以及发展前景等，您若想对中国LED外延片行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录:第一章报告简介1.1报告目的和目标1.2研究方法 第二章LED技术及前景概述2.1LED的定义2.2LED产业链组成2.3LED应用领域2.4LED技术优势2.5LED未来前景 第三章LED外延片、芯片原料及工艺技术分析3.1LED外延片、芯片产业概述3.2LED外延片、芯片定义3.2.1LED外延片定义3.2.2LED芯片定义3.3LED外延片衬底介绍3.3.1LED外延片衬底概述3.2.2LED外延片主要衬底名称性能价格市场比重分3.4LED外延片Mo源介绍3.4.1LED外延片Mo源概述3.4.2LED外延片Mo源材料种类3.4.3LED外延片Mo源材料选择对芯片颜色的影响3.5LED外延片MOCVD介绍3.5.1LED外延片生长方法概述3.5.2LED外延片MOCVD介绍及工作原理3.6LED芯片透明电极（P及N）的材料分析3.6.1LED芯片透明电极概述3.6.2LED芯片透明电极材料种类成本及性能3.7LED芯片RIE与ICP刻蚀技术分析3.7.1LED芯片刻蚀技术概述3.7.2RIE刻蚀技术介绍3.7.3ICP刻蚀技术介绍3.7.3RIE刻蚀技术与ICP刻蚀技术比较3.8LED芯片结构制造技术分析3.8.1LED芯片结构制造技术概述3.8.2正装结构LED芯片制造技术及优缺点分析3.8.3倒装结构LED芯片制造技术及优缺点分析3.8.4垂直结构LED芯片制造技术及优缺点分析 第四章全球LED外延片芯片产供销需及价格分析4.1全球LED外延片芯片产业市场概述4.2全球LED外延片芯片产能、产量统计分析4.2.1全球LED外延片产能、产量（万个）统计分析4.2.2全球LED芯片产能、产量（亿颗）统计分析4.3全球LED外延片芯片各地区产能产量（百万平方米）及所占市场份额4.3.1全球LED外延片各地区产能、产量（万个）统计分析4.3.2全球LED芯片各地区产能、产量（亿颗）统计分析4.4全球LED外延片芯片产能TOP20企业分析4.4.1全球LED外延片产能TOP20企业深入分析4.4.2全球LED芯片TOP20知名企业产能、产量（万个）统计分析4.5全球各种规格LED外延片芯片产量比重分析4.5.1全球各种规格LED外延片产量比重分析4.5.2全球各种规格LED芯片产量比重分析4.6全球LED外延片芯片供需关系4.6.1全球LED外延片需求量供需缺口4.6.2全球LED芯片需求量供需缺口情况4.7全球LED外延片芯片成本、价格、产值、利润率4.7.1全球LED外延

片成本价格产值利润分析4.7.2全球LED芯片成本价格产值利润分析 第五章国际LED外延片、芯片知名企业深度研究5.1Nichia (Japan) 5.1.1Nichia企业信息简介5.1.2Nichia.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.1.3Nichia.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.1.4Nichia.LED外延片、芯片下游客户5.1.5Nichia.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.2SAMSUNG (SouthKorea) 5.2.1SAMSUNG企业信息简介5.2.2SAMSUNG.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.2.3SAMSUNG.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.2.4SAMSUNG.LED外延片、芯片下游客户5.2.5SAMSUNG.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.3EPISTAR (TaiWan) 5.3.1EPISTAR企业信息简介5.3.2EPISTAR.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.3.3EPISTAR.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.3.4EPISTAR.LED外延片、芯片下游客户5.3.5EPISTAR.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.4Cree (USA.) 5.4.1Cree企业信息简介5.4.2CreeLED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.4.3CreeLED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.4.4CreeLED外延片、芯片下游客户5.4.5CreeLED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.5Osram (Germany) 5.5.1Osram企业信息简介5.5.2Osram.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.5.3Osram.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.5.4Osram.LED外延片、芯片下游客户5.5.5Osram.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.6PHILIPSLumileds (USA.Netherlands) 5.6.1PHILIPS企业信息简介5.6.2PHILIPSLED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.6.3PHILIPSLED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.6.4PHILIPSLED外延片、芯片下游客户5.6.5PHILIPSLED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.7SSC (SouthKorea) 5.7.1SSC企业信息简介5.7.2SSC.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.7.3SSC.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.7.4SSC.LED外延片、芯片下游客户5.7.5SSC.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.8LGIInnotek (SouthKorea) 5.8.1LGIInnotek企业信息简介5.8.2LGIInnotek.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.8.3LGIInnotek.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.8.4LGIInnotek.LED外延片、芯片下游客户5.8.5LGIInnotek.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.9ToyodaGosei (Japan) 5.9.1ToyodaGosei企业信息简介5.9.2ToyodaGosei.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.9.3ToyodaGosei.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.9.4ToyodaGosei.LED外延片、芯片下游客户5.9.5ToyodaGosei.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.10Semileds (USA.TaiwanChina) 5.10.1Semileds企业信息简介5.10.2SemiledsLED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.10.3SemiledsLED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情

况5.10.4SemiledsLED外延片、芯片下游客5.10.5SemiledsLED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.11HewlettPackard (USA.) 5.11.1HewlettPackard企业信息简介5.11.2HewlettPackardLED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.11.3HewlettPackardLED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.11.4HewlettPackardLED外延片、芯片下游客户5.11.5HewlettPackardLED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.12Lumination (USA.) 5.12.1Lumination.企业信息简介5.12.2Lumination.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.12.3Lumination.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.12.4Lumination.LED外延片、芯片下游客户5.12.5Lumination.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.13Bridgelux (USA.) 5.13.1Bridgelux企业信息简介5.13.2BridgeluxLED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析5.13.3BridgeluxLED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况5.13.4BridgeluxLED外延片、芯片下游客户5.13.5BridgeluxLED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析5.14SDK (Japan) 5.14.1SDK企业信息简介5.14.2SDK.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分5.14.3SDK.LED外延片、芯片原料及设备供货商合作情况5.14.4SDK.LED外延片、芯片下游客户5.14.5SDK.LED外延片、芯片在全球投产计划产能产量价格及销售情况分析 第六章中国LED外延片、芯片产供销需及价格分析6.1中国LED外延片芯片产业市场概述6.2中国LED外延片芯片产能、产量统计分析6.2.1中国LED外延片产能、产量（万个）统计分析6.2.2中国LED芯片产能、产量（万个）统计分析6.3中国LED外延片芯片各省市产能产量及所占市场份额6.3.1中国LED外延片各省市产能、产量（万个）统计分析6.3.2中国LED芯片各省市产能、产量（亿颗）统计分6.4中国LED外延片芯片产能TOP10企业分析6.4.1中国LED外延片产能TOP10企业深入分析6.4.2中国LED芯片产能TOP10企业深入分析6.5中国各种规格LED外延片芯片产量比重分析6.5.1中国各种规格LED外延片产量比重分析6.5.2中国各种规格LED芯片产量比重分析6.6中国LED外延片芯片供需关系6.6.1中国LED外延片需求量供需缺口6.6.2中国LED芯片需求量供需缺口6.7中国LED外延片芯片成本、价格、产值、利润率6.7.1中国LED外延片成本价格产值利润分析6.7.2中国LED芯片成本价格产值利润分析 第七章中国LED外延片、芯片核心企业深度研究7.1三安光电（厦门）7.1.1三安光电企业信息简介7.1.2三安光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.1.3三安光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.1.4三安光电.LED外延片、芯片下游客户7.1.5三安光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.2士兰微电子（浙江）7.2.1士兰微电子企业信息简介7.2.2士兰微电子.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.2.3士兰微电子.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.2.4士兰微电子.LED外延片、芯片下游客户7.2.5士兰微电子.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.3浪潮华光（山东）7.3.1浪潮华光企业信息简介7.3.2浪潮华光.LED外延片、芯片生产

工艺及产品特点分析7.3.3浪潮华光.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.3.4浪潮华光.LED外延片、芯片下游客户7.3.5浪潮华光.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.4大连美（辽宁）7.4.1大连美企业信息简介7.4.2大连美.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.4.3大连美.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.4.4大连美.LED外延片、芯片下游客户7.4.5大连美.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.5乾照光电（厦门）7.5.1乾照光电企业信息简介7.5.2乾照光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.5.3乾照光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.5.4乾照光电.LED外延片、芯片下游客户7.5.5乾照光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.6上海蓝光（上海）7.6.1上海蓝光企业信息简介7.6.2上海蓝光LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.6.3上海蓝光LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.6.4上海蓝光LED外延片、芯片下游客户7.6.5上海蓝光LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.7华灿光电（湖北）7.7.1华灿光电企业信息简介7.7.2华灿光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.7.3华灿光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.7.4华灿光电.LED外延片、芯片下游客户7.7.5华灿光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.8迪源光电（湖北）7.8.1迪源光电企业信息简介7.8.2迪源光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.8.3迪源光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.8.4迪源光电.LED外延片、芯片下游客户7.8.5迪源光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.9晶科电子（广州）7.9.1晶科电子企业信息简介7.9.2晶科电子.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.9.3晶科电子.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.9.4晶科电子.LED外延片、芯片下游客户7.9.5晶科电子.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.10江门真明丽（广东）7.10.1江门真明丽企业信息简介7.10.2江门真明丽.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.10.3江门真明丽.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.10.4江门真明丽.LED外延片、芯片下游客户7.10.5江门真明丽.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.11方大集团（广东）7.11.1方大集团企业信息简介7.11.2方大集团.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.11.3方大集团.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.11.4方大集团.LED外延片、芯片下游客户7.11.5方大集团.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.12同方股份7.12.1同方股份企业信息简介7.12.2同方股份.LED外延片、芯片产品分析（颜色结构材料功率等）7.12.3同方股份.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.12.4同方股份.LED外延片、芯片下游客户7.12.5同方股份.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.13联创光电（江西）7.13.1联创光电企业信息简介7.13.2联创光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.13.3联创光电.LED外延片

、芯片上游材料设备供货商合作情况7.13.4联创光电.LED外延片、芯片下游客户7.13.5联创光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.14德豪润达（广东）7.14.1德豪润达企业信息简介7.14.2德豪润达.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.14.3德豪润达.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.14.4德豪润达.LED外延片、芯片下游客户7.14.5德豪润达.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.15清芯光电7.15.1清芯光电企业信息简介7.15.2清芯光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.15.3清芯光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.15.4清芯光电.LED外延片、芯片下游客户7.15.5清芯光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.16奥伦德（广东）7.16.1奥伦德企业信息简介7.16.2奥伦德.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.16.3奥伦德.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.16.4奥伦德.LED外延片、芯片下游客户7.16.5奥伦德.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.17长城开发（广东）7.17.1长城开发企业信息简介7.17.2长城开发.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.17.3长城开发.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.17.4长城开发.LED外延片、芯片下游客户7.17.5长城开发.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.18上海蓝宝（上海）7.18.1上海蓝宝企业信息简介7.18.2上海蓝宝.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.18.3上海蓝宝.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.18.4上海蓝宝.LED外延片、芯片客户7.18.5上海蓝宝.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.19世纪晶源（广州）7.19.1世纪晶源企业信息简介7.19.2世纪晶源.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.19.3世纪晶源.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.19.4世纪晶源.LED外延片、芯片下游客户7.19.5世纪晶源.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.20晶能光电（江西）7.20.1晶能光电企业信息简介7.20.2晶能光电.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.20.3晶能光电.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.20.4晶能光电.LED外延片、芯片下游客户7.20.5晶能光电.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.21福地电子（广东）7.21.1福地电子企业信息简介7.21.2福地电子.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.21.3福地电子.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.21.4福地电子.LED外延片、芯片下游客户7.21.5福地电子.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.22福日电子（福建）7.22.1福日电子企业信息简介7.22.2福日电子.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.22.3福日电子.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.22.4福日电子.LED外延片、芯片下游客户7.22.5福日电子.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析7.23浙江阳光（浙江）7.23.1浙江阳光企业信息简介7.23.2浙江阳光.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.23.3浙江阳光.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情况7.23.4

浙江阳光.LED外延片、芯片下游客户7.23.5浙江阳光.LED外延片、芯片在国内投产计划产能产量价格及销售情况分析5.24华夏集成（江苏）（ ）7.24.1华夏集成企业信息简介7.24.2华夏集成.LED外延片、芯片生产工艺及产品特点分析7.24.3华夏集成.LED外延片、芯片上游材料设备供货商合作情

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/174519.html>